

MLCC 龙头释放扩产信号，半导体设备零部件交期延长

——电子行业跟踪报告

强于大市 (维持)

2026 年 09 月 21 日

行业核心观点:

上周申万电子指数上涨 6.06%，跑赢沪深 300 指数和创业板指数。MLCC 龙头村田计划将 AI 服务器不可或缺的多层陶瓷电容器 (MLCC) 产能，在 2028 财年 (截至 2028 年 3 月) 较当前水平提升两成；在 AI 算力需求催化下，有半导体制造设备关键零部件的交货周期已延长了一倍以上。我们认为算力建设方兴未艾，算力产业链中高景气细分赛道如 PCB、存储、MLCC 等需求旺盛，均处于景气扩张周期，亦有望提振上游设备、先进封装等需求，建议关注 PCB、存储、MLCC、半导体设备及材料、先进封装等产业链投资机遇。

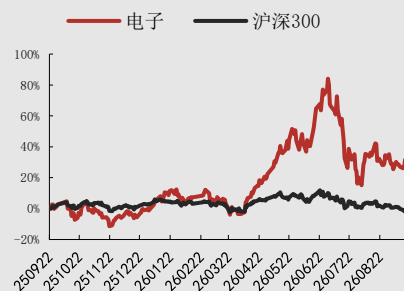
投资要点:

产业动态: (1) **MLCC**，据科创板日报援引日经新闻报道，MLCC 龙头村田计划将 AI 服务器不可或缺的多层陶瓷电容器 (MLCC) 产能，在 2028 财年 (截至 2028 年 3 月) 较当前水平提升两成。(2) **半导体设备**，据科创板日报援引韩国科技媒体 ETNEWS 报道，有半导体制造设备关键零部件的交货周期已延长了一倍以上，行业正面临供应短缺的困境。随着人工智能的普及和基础设施投资的大幅增长，AI 芯片和存储芯片的需求显著增加，半导体设备需求水涨船高。(3) **芯片**，9 月 17 日，在 2026 年度华为全联接大会上，华为轮值董事长汪涛宣布，昇腾 960 系列芯片已提前完成研发准备，整体性能实现翻倍提升。据介绍，昇腾 960DT 会在 2027 年第一季度正式推出，较原先的规划提前了三个季度。(4) **先进封装**，根据 TrendForce 集邦咨询最新半导体先进封装产业研究，随着 GPU 厂商、超大型云端服务供应商 (CSP) 持续开发更强大、功能多元的 AI 芯片，2.5D 封装技术的一项发展重点在于扩大封装面积。其中，TSMC (台积电) CoWoS-L 尽管面临 Intel (英特尔) EMIB-T 的竞争，但凭借其技术成熟度与良率优势，预计至 2028 年仍将是 AI 芯片的主流封装方案。

行业估值: 从估值情况来看，截至 2026 年 9 月 20 日，SW 电子板块 PE (TTM) 为 69.07 倍，2019 年至 2026 年 9 月 20 日 SW 电子板块 PE (TTM) 均值为 56.86 倍，行业估值高于近年中枢水平。

风险因素: 中美科技摩擦加剧；AI 应用发展不及预期；国产技术突破不及预期；下游终端需求不及预期；市场竞争加剧。

行业相对沪深 300 指数表现



数据来源: 聚源, 万联证券研究所

相关研究

MLCC 龙头停产部分料号, 苹果发布首款折叠屏产品

三星电机获 MLCC 大订单, 半导体设备市场规模稳步增长

英伟达业绩指引较为积极, 三星电机调涨第四季度产品报价

分析师: 夏清莹

执业证书编号: S0270520050001

电话: (0755) 8322 3620

邮箱: xiaqy1@wlzq.com.cn

分析师: 陈达

执业证书编号: S0270524080001

电话: 13122771895

邮箱: chenda@wlzq.com.cn

正文目录

1 行业周观点.....3

2 市场行情回顾.....4

3 产业动态.....5

 3.1 MLCC：全球龙头厂商村田计划将高端 MLCC 产能扩大两成.....5

 3.2 半导体设备：AI 算力需求推动半导体设备零部件交货周期翻倍5

 3.3 芯片：华为昇腾 960 系列芯片已提前完成研发准备，整体性能提升6

 3.4 先进封装：CoWoS-L 预计稳居 AI 芯片先进封装主流至 2028 年6

4 风险提示.....6

图表 1： 申万一级周涨跌幅（%）4

图表 2： 申万一级年涨跌幅（%）4

图表 3： 申万电子板块估值情况（2019 年至今）5

1 行业周观点

MLCC龙头村田计划将AI服务器不可或缺的多层陶瓷电容器（MLCC）产能，在2028财年（截至2028年3月）较当前水平提升两成；在AI算力需求催化下，有半导体制造设备关键零部件的交货周期已延长了一倍以上。我们认为国产算力建设方兴未艾，算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储、MLCC等需求旺盛，均处于景气扩张周期，有望提振上游设备、先进封装等需求，建议关注PCB、存储、MLCC、半导体设备及材料、先进封装等产业链投资机遇。

中长期视角，我们建议把握AI高景气产业周期和国产突破与扩产带来的投资机遇。AI浪潮持续推进，算力建设方兴未艾，算力关键硬件环节需求旺盛，存储、PCB、MLCC等正处于景气扩张周期；此外，国产厂商先进技术创新突破，为AI芯片、先进封装优质厂商带来发展机遇，同时成熟领域产能扩充，有望提振上游半导体设备及材料等环节需求，带来投资机遇。

1) PCB，AI PCB行业受益于全球算力建设需求，高多层板及HDI市场需求增速相对较快，高端PCB扩产有望提振上游设备及材料需求，材料方面覆铜板供不应求推动产品涨价，设备方面曝光设备及钻孔设备等细分领域增速更高。建议关注在HDI、多层板等高端PCB领域前瞻布局的PCB龙头厂商，同时主流PCB厂商加速扩产，有望拉动上游设备及材料需求，建议关注覆铜板材料、钻孔及曝光设备等领域的龙头厂商。

2) 存储，受益于AI算力建设，存储供应持续偏紧，产品合约价格持续走高，行业整体盈利能力有望增强，同时我国存储龙头厂商积极把握行业发展机遇，市场份额跻身前列。建议关注DRAM及NAND Flash领域国产龙头厂商，在存储需求高企、供给偏紧或导致产品价格维持较高位的背景下，厂商盈利能力持续提升有望带来投资机遇。

3) MLCC，AI算力、新能源车等需求驱动高端MLCC需求快速增长，市场规模稳步提升，全球龙头厂商已调涨AI及车规产品价格，行业整体有望步入景气周期。建议关注前瞻布局高端MLCC产品的国产龙头厂商，在行业景气回升时有望具备较强盈利修复弹性。

4) 先进封装，华为发布“韬定律”，通过逻辑折叠等技术创新推动芯片性能提升，先进封装是实践的重要技术环节之一，市场规模稳步增长，且全球芯片大厂积极布局该领域。建议关注在先进封装各前沿技术领域前瞻布局的优质厂商，如在混合键合技术、玻璃基板材料、光互连封装、Chiplet技术等领域取得突破的龙头厂商。

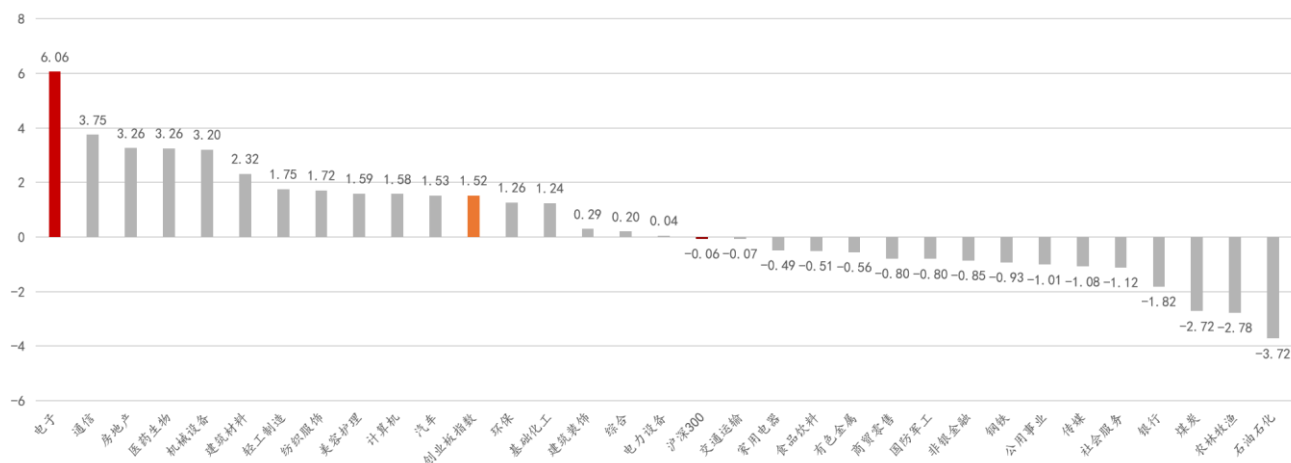
5) AI芯片，国产AI芯片市场份额快速提升，由国产芯片、国产框架、国产大模型构成的完整AI生态闭环正加速形成。建议关注AI芯片领域技术创新突破并取得下游客户认可的国产优质厂商，在国产算力加速建设背景下产品出货需求旺盛有望带来投资机遇。

6) 半导体设备及材料，半导体各行业优质公司积极筹备上市，存储芯片龙头公司业绩亮眼，国内晶圆厂加速推动产能扩充建设，有望提振上游半导体设备、零部件及材料需求，同时部分环节仍有较大国产替代空间。建议关注半导体设备、零部件及材料领域的优质龙头厂商，受益于下游扩产及国产替代双重增长动力，产品出货需求旺盛有望带来投资机遇。

2 市场行情回顾

上周，申万电子行业跑赢沪深300指数和创业板指数。上周申万电子指数上涨6.06%，在31个申万一级行业中排第1，沪深300指数下跌0.06%，创业板指数上涨1.52%，申万电子跑赢沪深300指数6.12个百分点，跑赢创业板指数4.54个百分点。

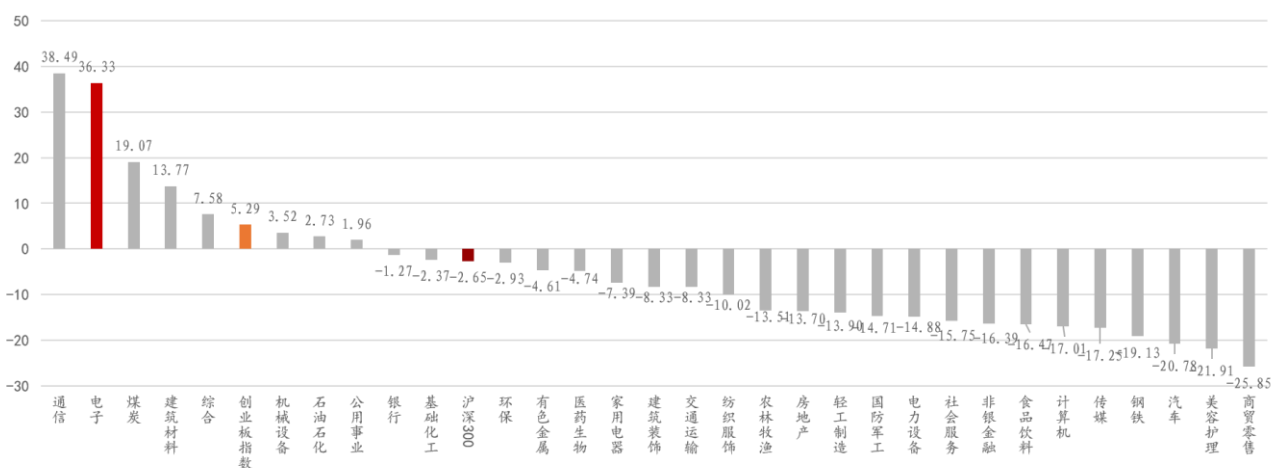
图表1: 申万一级周涨跌幅 (%)



资料来源: iFinD, 万联证券研究所

2026年初以来，申万电子行业跑赢沪深300指数和创业板指数。2026年初至2026年9月20日，沪深300指数下跌2.65%，创业板指数上涨5.29%，申万电子行业上涨36.33%，在31个申万一级行业中排名第2位，跑赢沪深300指数38.97个百分点，跑赢创业板指数31.03个百分点。

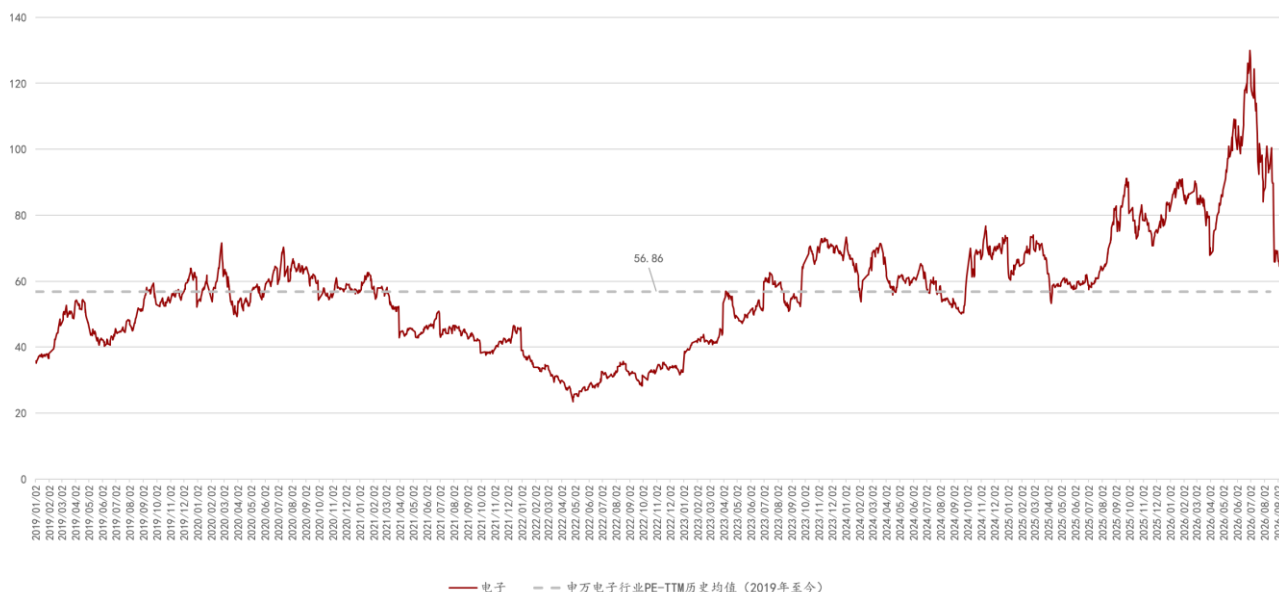
图表2: 申万一级年涨跌幅 (%)



资料来源: iFinD, 万联证券研究所

申万电子行业估值略高于近年估值情况来看，截至2026年9月20日，SW电子板块PE (TTM) 为69.07倍，2019年至2026年9月20日SW电子板块PE (TTM) 均值为56.86倍，行业估值高于近年中枢水平。基于AI算力加速建设、半导体产业链景气上行等趋势利好，我们认为板块估值仍有上行空间。

图表3: 申万电子板块估值情况 (2019 年至今)



资料来源: iFinD, 万联证券研究所

3 产业动态

3.1 MLCC: 全球龙头厂商村田计划将高端 MLCC 产能扩大两成

据科创板日报援引日经新闻报道, MLCC龙头村田计划将AI服务器不可或缺的多层陶瓷电容器 (MLCC) 产能, 在2028财年 (截至2028年3月) 较当前水平提升两成。村田副社长南出雅范接受采访时表示: “着眼于未来3至5年, 公司正研讨评估包含厂房在内的产能扩张计划。我认为这次的评估将比以往更加大胆。目前内部尚未敲定最终方案, 但已经进入深度论证阶段。在海内外工厂新建大型厂房, 是可选路径之一。” 其预计, 面向AI领域的MLCC需求增长至少将延续至2028年。中长期来看, 市场将从作为基础设施的AI数据中心, 拓展至端侧AI设备。为实现产品线优化, 村田此前已停产部分消费级和车规级产品: 就在本月, 村田宣布停产部分MLCC产品并扩充其他产能。(来源: 科创板日报)

3.2 半导体设备: AI 算力需求推动半导体设备零部件交货周期翻倍

据科创板日报援引韩国科技媒体ETNEWS报道, 有半导体制造设备关键零部件的交货周期已延长了一倍以上, 行业正面临供应短缺的困境。一家生产沉积设备的公司的一位高管表示: “过去订购沉积设备所需的零部件后四个月就能收到, 但最近, 交货时间已经延长到了10个月。” 另一家半导体激光加工设备制造商从日本采购关键零部件, 交货期可能长达40个月。该公司一位负责人表示: “我们愿意支付溢价以加快交货速度, 但被告知, 由于零部件供应商产能有限, 缩短交货周期非常困难。” 该负责人补充道: “除非找到替代供应链, 否则很难立即开始生产设备。” 另据报道, 有封装设备制造商虽已建立本土零部件供应链, 但交货也面临延误。该公司一位高管表示: “情况比从海外采购要好, 但零部件的到货时间仍然比平时长约50%。” 这意味着, 原本只需四个月即可到货的封装设备零部件, 现在需要六个月甚至更长时间才能交付。随着人工智能的普及和基础设施投资的大幅增长, AI芯片和存储芯片的需求显著增加, 半导体设备需求水涨船高。

当前AI需求持续超预期, 晶圆厂扩产有望加速向设备及核心零部件环节传导, 全球晶圆制造龙头台积电2026年设备采购数量持续上修。9月2日, 台积电资深副总经理暨副

共同营运长侯永清在SEMICON Taiwan表示，以2025年底对2026年设备采购数量预估1倍为基准，26Q1已上调至1.5倍，7月进一步升至1.9倍。（来源：科创板日报）

3.3 芯片：华为昇腾 960 系列芯片已提前完成研发准备，整体性能提升

9月17日，在2026年度华为全联接大会上，华为轮值董事长汪涛宣布，昇腾960系列芯片已提前完成研发准备，整体性能实现翻倍提升。据介绍，昇腾960DT会在2027年第一季度正式推出，较原先的规划提前了三个季度；昇腾960PR则定于2027年第三季度发布，比原定计划提前一个季度。配置方面，昇腾960DT微架构还是SIMD/SIMT，算力翻倍提高到2PFLOPS (FP8) /4PFLOPS (FP4)，支持FP32/HF32/FP16/BF16/FP8/MXFP8/HiF8/MXFP4/HiF4等数据格式，互联带宽为2.2TB/s。访存容量翻倍到288GB、带宽达到9.6TB/s。昇腾960PR的变化主要是FP4算力提升到了8PFLOPS，但是访存容量降低到了192GB，带宽也降至2.4TB/s。汪涛表示，昇腾超节点已经累计部署超过1000套，昇腾950超节点已经开始规模商用。（来源：芯智讯）

3.4 先进封装：CoWoS-L 预计稳居 AI 芯片先进封装主流至 2028 年

根据TrendForce集邦咨询最新半导体先进封装产业研究，随着GPU厂商、超大型云端服务供应商（CSP）持续开发更强大、功能多元的AI芯片，2.5D封装技术的一项发展重点在于扩大封装面积。其中，TSMC（台积电）CoWoS-L尽管面临Intel（英特尔）EMIB-T的竞争，但凭借其技术成熟度与良率优势，预计至2028年仍将是AI芯片的主流封装方案。

TrendForce集邦咨询指出，过去AI Server芯片主要采用TSMC CoWoS-S封装技术，以硅中介层整合HBM与计算芯片（Compute Die），实现生成式AI应用所需的算力性能。然而，在芯片面积持续扩张、需要整合更多HBM模块的情况下，硅中介层制造面临物理极限，除改变中介层材质外，也需转向光罩（又称光掩膜）曝光倍数更大的CoWoS-L解决方案，通过中介层嵌入高速传输的硅桥（Si Bridge）芯片，更弹性解决Compute Die与HBM封装、传输问题。然而，CoWoS-L提升单芯片更大的中介层尺寸推高芯片封装成本，加上TSMC产能供不应求，促使Intel EMIB技术成为备选。（来源：TrendForce集邦咨询）

4 风险提示

中美科技摩擦加剧；AI应用发展不及预期；国产技术突破不及预期；下游终端需求不及预期；市场竞争加剧。

行业投资评级

强于大市：未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%以上；

同步大市：未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%至-10%之间；

弱于大市：未来6个月内行业指数相对大盘跌幅10%以上。

公司投资评级

买入：未来6个月内公司相对大盘涨幅15%以上；

增持：未来6个月内公司相对大盘涨幅5%至15%；

观望：未来6个月内公司相对大盘涨幅-5%至5%；

卖出：未来6个月内公司相对大盘跌幅5%以上。

基准指数：沪深300指数

风险提示

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

证券分析师承诺

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

免责声明

万联证券股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家覆盖证券经纪、投资银行、投资管理和证券咨询等多项业务的全国性综合类证券公司。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。本报告中的信息或所表述的意见并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。在法律许可情况下，本公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息撰写，本公司力求但不保证这些信息的准确性及完整性，也不保证文中的观点或陈述不会发生任何变更。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。分析师任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告的版权仅为本公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表和引用。未经我方许可而引用、刊发或转载的引起法律后果和造成我公司经济损失的概由对方承担，我公司保留追究的权利。

万联证券股份有限公司 研究所

上海浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦

北京西城区平安里西大街 28 号中海国际中心

深圳福田区深南大道 2007 号金地中心

广州天河区珠江东路 11 号高德置地广场